

Prensa De Laboratorio Automática De Calentamiento De Doble Plato Para Sinterización Y Compactación 120X120Mm

Número de artículo: KT-AHQ



Introducción

Esta prensa de laboratorio automática de caliente combina compactación hidráulica de alta precisión con calentamiento independiente de doble plato hasta 300°C, ofreciendo control programable de múltiples etapas y enfriamiento rápido por agua para maximizar la eficiencia y la consistencia de la muestra en entornos de investigación y laboratorio industrial exigentes.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio Clave
Investigación de Energía de Baterías	Fabricación de discos de electrolitos de estado sólido y componentes de células de bolsa de baterías de litio bajo temperatura y presión controladas.	Maximiza la densidad electroquímica y la conductividad, asegurando resultados óptimos de prueba de celdas de batería.
Pruebas Farmacéuticas	Compactación de polvos farmacéuticos, excipientes e ingredientes activos en tabletas precisas o especímenes de prueba.	Asegura una formulación de dosis exacta y una excelente consistencia estructural para pruebas de disolución.
Cerámicas Avanzadas	Sinterización y consolidación de electrocerámicas, polvos de óxidos y materiales cerámicos estructurales bajo alta presión térmica.	Elimina la porosidad y los vacíos internos, entregando piezas de alta densidad con resistencia mecánica superior.
Ingeniería de Catalizadores	Prensado de mezclas de polvos de catalizador en pellets o sustratos catalíticos altamente activos y duraderos.	Optimiza el área de superficie activa mientras asegura la estabilidad mecánica a largo plazo en entornos de reactores.
Preparación de Muestras Espectroscópicas	Preparación de películas de polímero ultra delgadas y altamente uniformes o discos ópticos para espectrofotometría FTIR y fluorescencia.	Elimina variaciones de espesor, mejorando la precisión y repetibilidad de los resultados analíticos.
Embalaje de Semiconductores	Laminación de sustratos electrónicos, materiales de interfaz térmica y compuestos de moldeo de semiconductores bajo fuerza precisa.	Previene la delaminación y asegura vías de disipación térmica uniformes en los componentes.

Parámetro de Especificación	Datos Técnicos (Modelo: KT-AHQ)
Dimensiones del Plato de Prensado	120 mm x 120 mm
Temperatura Máxima	300°C (Control Independiente de Plato Superior e Inferior)
Método de Control de Temperatura	Control de Bucle Cerrado Inteligente PID de Doble Zona
Precisión de Temperatura	±1°C
Fuerza Máxima de Prensado	20 Toneladas (Opciones personalizadas disponibles)
Mecanismo de Enfriamiento	Sistema de Enfriamiento Rápido por Agua Integrado
Modos de Operación	Modo Estándar (Una sola etapa) y Modo Avanzado (Múltiples etapas)
Pasos Programables	Programación de hasta 18 pasos
Pantalla e Interfaz de Usuario	Pantalla Táctil a Color de 7 pulgadas con Visualización de Curvas Gráficas
Interfaz de Datos	Puerto USB para registro y exportación de datos (Formato CSV)
Escudo de Seguridad	Capota de Protección Transparente de Acrílico / Policarbonato

Parámetro de Especificación

Datos Técnicos (Modelo: KT-AHQ)

Suministro de Energía

220V CA, 50/60 Hz, Monofásico (110V opcional)